



特点

- 采用德国产玻璃钝化芯片焊接，优良的温度特性和功率循环能力
- 采用进口高级方形芯片支撑板，经真空 + 氢气保护焊接工艺，保证焊接层无空洞，使用更可靠。
- 采用 DCB 板及其它高级导热绝缘材料，导热性能好，导热基板不带电
- 典型应用
- 开关电源的输入整流、软启动电容充电、电气拖动和辅助电流
- 逆变焊机、电流充电直流电源
- 仪器设备的直流电源、PWM 变频器的输入整流电源、直流电机励磁电源

| | |
|-----------|-------------------|
| I_D | 200A |
| V_{RRM} | 600-2000V |
| I_{FSM} | 2.1 KA |
| I^2t | 22.1 $10^3 a^2 s$ |

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 结温 $T_J (^\circ C)$ | 参数值 | | | 单位 |
|---------------|-------------|---|------------------------|------|----|------|---------------------|
| | | | | 最小 | 典型 | 最大 | |
| I_D | 直流输出电流 | 单相全波整流电路, $T_C=100^\circ C$ | 150 | | | 200 | A |
| V_{RRM} | 反向重复峰值电压 | $V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}-200V$ | 150 | 600 | | 2000 | V |
| I_{RRM} | 反向重复峰值电流 | at V_{RRM} | 150 | | | 10 | mA |
| I_{FSM} | 正向不重复浪涌电流 | 10ms 底宽, 正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$ | 150 | | | 2.1 | KA |
| I^2t | 浪涌电流平方时间积 | | | | | 22.1 | $A^{2S} \cdot 10^3$ |
| V_{FO} | 门槛电压 | | 150 | | | 0.80 | V |
| r_F | 斜率电阻 | | | | | 2.8 | $m\Omega$ |
| V_{FM} | 正向峰值电压 | $I_{FM}=150A$ | 25 | | | 1.50 | V |
| $R_{th(j-c)}$ | 热阻抗 (结至壳) | 单面散热 | | | | 0.10 | $^\circ C/W$ |
| $R_{th(c-h)}$ | 热阻抗 (壳至散热器) | 单面散热 | | | | 0.07 | $^\circ C/W$ |
| V_{iso} | 绝缘电压 | 50Hz, R.M.S, t=1min, $I_{iso}: 1mA(max)$ | | 2500 | | | V |
| F_M | 安装扭矩 (M5) | | | | 6 | | N·m |
| | 安装扭矩 (M6) | | | | 4 | | N·m |
| T_{stq} | 存温度 | | | -40 | | 125 | $^\circ C$ |
| W_t | 质量 | | | | | | g |
| Outline | 外形 | | | | | | |



上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MDS200A 三相整流桥模块

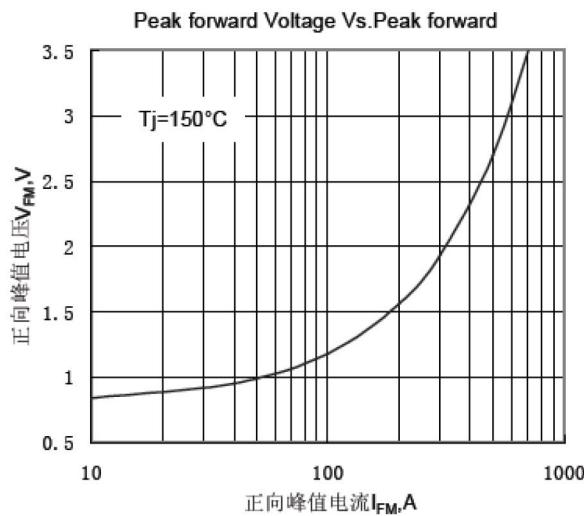


Fig.1 正向伏安特性曲线

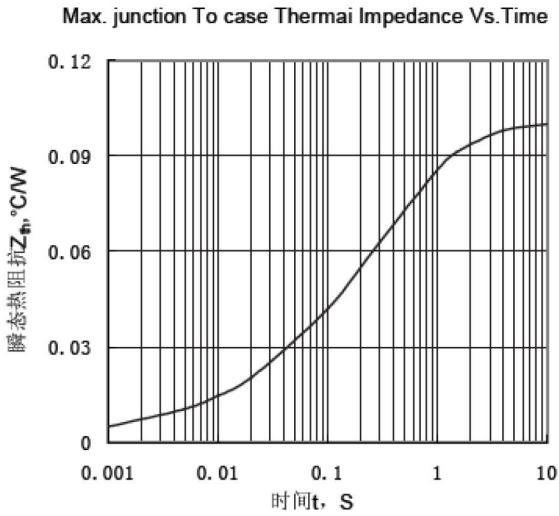


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

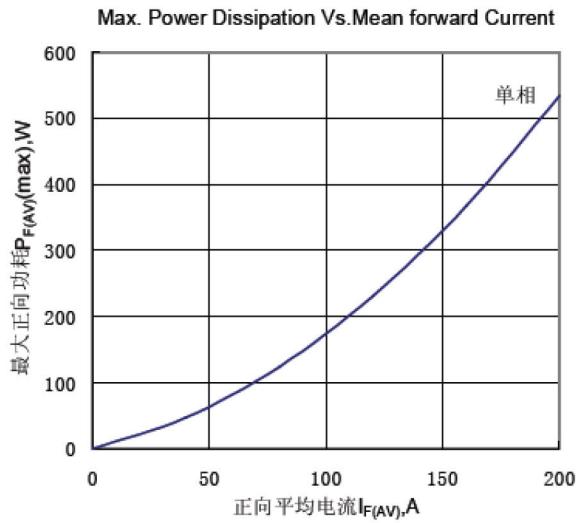


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

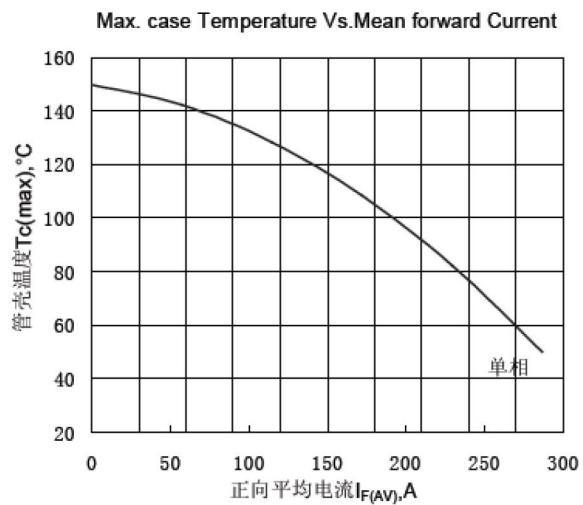


Fig.4 管壳温度与平均电流关系曲线

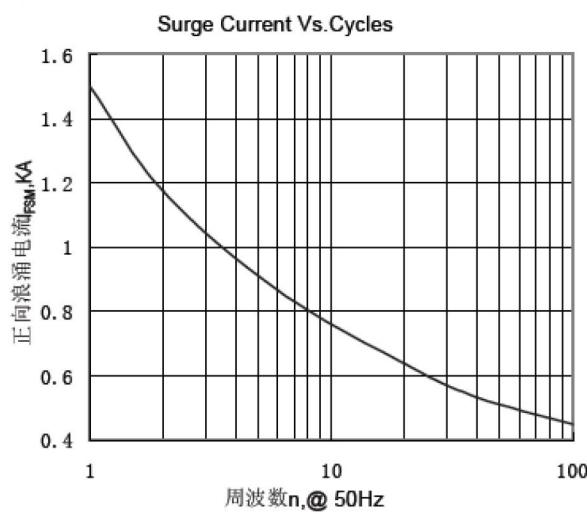


Fig.5 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

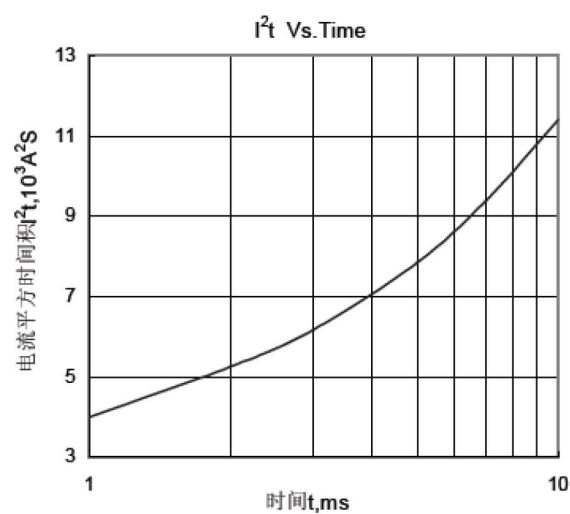


Fig.6 I^2t 特性曲线



上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MDS200A 三相整流桥模块

外形图：

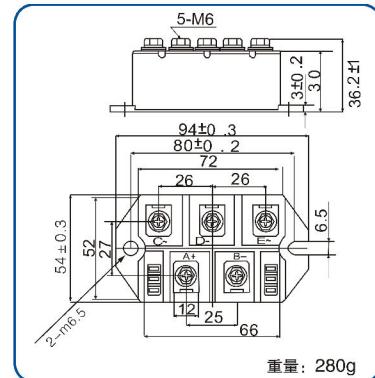
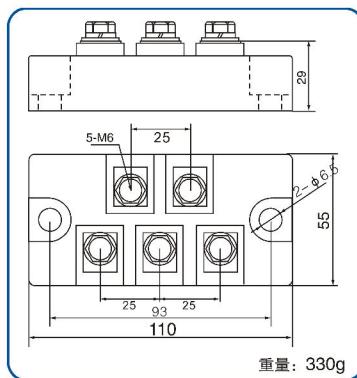
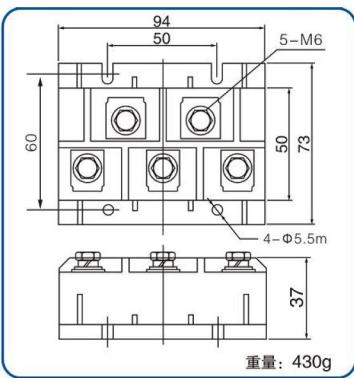
代号：103A



代号：103A-1



代号：103A-2



线路图：

